

● レイテックスの装置戦略

デバイス向け新製品を投入
絶え間ない技術革新を継続

今年も新製品を投入

レイテックスは、毎年SEMICON Japanに向けて新製品を発表しているが、今年も新製品の投入を予定している。今年は、Siウェーハ向けに加えて、デバイス向けにも注力した2本柱でいく計画だ。

Siウェーハメーカー向けでは裏面やエッジの検出感度を向上させた「EdgeScan」を発表する。一方、デバイスメーカー向けではデバイス用にアレンジした「EdgeScan」を発表する予定だ。デバイス用に開発した新型エンジンを搭載し、高感度検出を図った他、ADCの開発も進めている。また、Siウェーハ向けでは、平坦度・Nanotopography検査用の「Dyna-Search」の新製品も用意している。

Siウェーハメーカーを完全制覇

同社の主力装置であるEdgeScanは、ウェーハのエッジを検査するという新しいニーズを生み出した。これまで60台以上のEdgeScanを納入、現在も継続的に受注がある。また、これまでEdgeScanを導入していなかったSiウェーハメーカーにも、納入が決定している。これにより、Siウェーハメーカーを完全制覇、エッジ検査の独占体制を確立した。EdgeScanの成功を足掛かりに、EdgeScanシリーズとして、裏面検査、エッジグリップタイプ、端部除外領域検査、モジュールタイプ、エッジ・裏面对応複合機など立て続けに新製品をリリース、いずれもヒットさせている。

予想以上に強いデバイスプロセスでのニーズ

Siウェーハに続く次のステップとしてデバイスプロセスにおけるエッジ検査をターゲットにしてきた。ここ数年、デバイスプロセスにおけるエッジや裏面検査のニーズをリサーチしてきたが、予想以上にニーズがあることがわかってきた。特に300mmウェーハでの生産では、エッジ検査が不可欠になっていくと見ている。300mmウェーハでのデバイスプロセスにおけるウェーハ割れが深刻化しているが、こ

レイテックスの会社概要

設立：1988年7月19日
代表者：高村 淳
資本金：2億5000万円
売上高：
2002年5月期 10億4000万円
2003年5月期 14億5000万円
事業内容：ウェーハ自動検査
装置の製造・販売など

れらはウェーハのエッジの傷などを起因とするケースが多く、エッジ検査は必須になりつつある。

さらに先をゆく

ウェーハのエッジを見るという文化は、同社が確立したもののだが、その市場性に着目して多くの競合メーカーが登場してきている。しかし、特に気にはしていないという。1つはエッジ検査はまだまだ普及期であり、競合メーカーが現れることにより、話題が高まり、注目を集めることは、全体のパイを広げる意味でも必要なことだと考えているためだ。もう1つは、同社では絶えず、技術革新を進めているため、競合メーカーには、追いつかれないという絶対の自信を持っている。EdgeScanの開発当初、画像比較方式によるエッジ検査のアイデアはいくつもあったが、同社ではあくまでも量産に適用できる検査方式を追求し、レーザによる検査技術を開発した。単にエッジを検査することではなく、「ウェーハ外観検査の自動化をトータルで提供」という同社のコンセプトに基づき様々な要素技術や装置を開発してきた。既存の装置も絶えず改良を進めており、技術・装置ともに進化を続けている。

また、日本だけでなく海外展開も積極的に進めており、米国には米国人を設立、2004年1月から本格的にスタートする。さらに、2004年には欧州でのサービス拠点の設置も計画している。



代表取締役社長 高村 淳氏